

<<芯片尺寸封装>>

图书基本信息

书名：<<芯片尺寸封装>>

13位ISBN编号：9787302073765

10位ISBN编号：7302073767

出版时间：2003-10

出版时间：清华大学出版社

作者：贾松良

页数：435

字数：570000

译者：刘汉诚,贾松良

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<芯片尺寸封装>>

内容概要

芯片尺寸封装（CSP）是20世纪90年代初兴起的一种高封装效率的IC封装，其封装尺寸小、封装实体薄，多数具有阵列式排式的引出端，便于测试、老炼和表面安装式组装，非常适合于便携式、高密度或高频电子器件的封装。

本书全面介绍了四大类40多种不同结构的芯片尺寸封装，说明了每种封装的设计原理、封装结构、材料、制造工艺、性能、可靠性及应用。

本书可作为从事芯片尺寸封装的研究、文教使用人员的参考书，也可作为相关专业高等院校高年级和研究生的参考书。

<<芯片尺寸封装>>

书籍目录

第1篇 用于CSP的倒装芯片和引线键合 第1章 CSP基板上焊凸点倒装芯和引线键合芯片的比较第2篇 基于定制引线框架的CSP 第2章 Fujitsu公司的小外形无引线/C形引线封装 (SON/SOC) 第3章 Fujitsu公司的焊凸点片式载体 (BCC) 第4章 Fujitsu公司的MicroBGA和四边无引线扁平封装 (QFN) 第5章 Hitachi Cable 公司的芯片上引线的芯片尺寸封装 (LOC-CSP) 第6章 Hitachi Cable 公司的微凸点阵列封装 (MSA) 第7章 LG Semicon公司的底部引线塑料封装 (BLP) 第8章 TI Japan公司的芯片引线 (LOC) 存储器芯片尺寸封装 (MCSP) 第3篇 挠性基板CSP 第9章 3M公司的增强型挠性CSP 第10章 GE公司的挠性板上的芯片尺寸封装 (COF-CSP) 第11章 Hitachi公司用于存储器件的芯片尺寸封装 第12章 IZM的flexPAC 第13章 NEC公司的窄节距焊球阵列 (FPBGA) 第14章 Nitto Denko公司的模塑芯片尺寸封装 (MCSP) 第15章 Sharp公司的芯片尺寸封装 第16章 Tessera公司的微焊球阵列 第17章 TI Japan 公司的Micro-Star BGA 第18章 TI Japan公司使用挠性基板的存储器芯片尺寸封装第4篇 刚性基板CSP 第19章 Amkor/Anam公司的芯片阵列封装 第20章 EPS公司的低成本焊凸点倒装芯片NuCSP 第21章 IBM公司的陶瓷小型焊球阵列封装 第22章 IBM公司的倒装芯片-塑料焊球阵列封装.....

<<芯片尺寸封装>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>